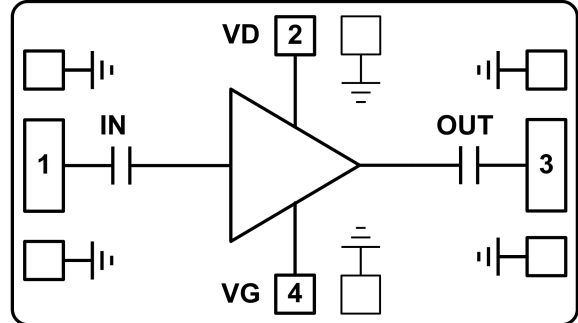




主要特点

- 工作频率: 6 - 18 GHz
- 增益: 19 dB
- P1dB: +15 dBm
- 噪声系数: 1.8 dB
- 自偏置供电: +3.5 V @ 89 mA
- 输入/输出: 50 Ohm 匹配
- 芯片尺寸: 1.3 × 1.3 × 0.1 mm<sup>3</sup>

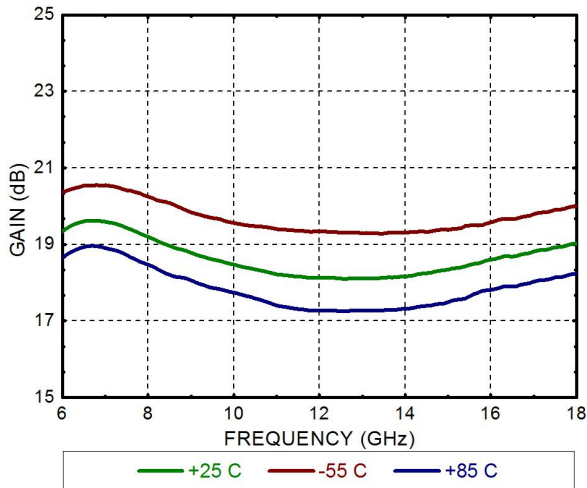
功能框图



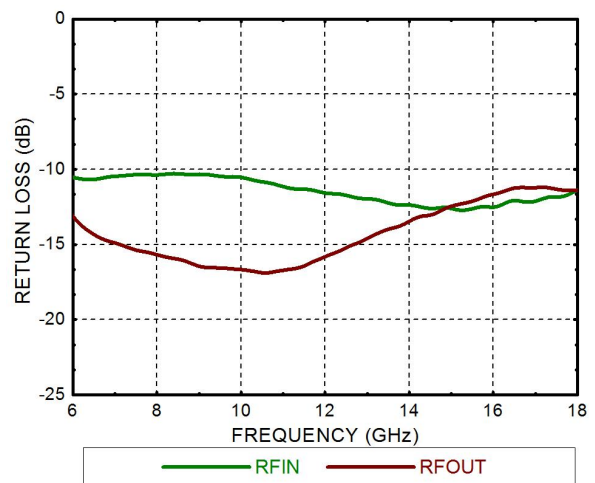
性能指标 ( $T_A = +25^\circ\text{C}$ ,  $V_{DD} = +3.5\text{ V}$ ,  $I_{DD} = 89\text{ mA}$ )

参数	最小	典型	最大	单位
频率范围	6 - 18			GHz
增益		19		dB
增益平坦度		±1		dB
输入回波损耗		10		dB
输出回波损耗		10		dB
输出功率 1dB 压缩点		15		dBm
饱和功率		18		dBm
输出 IP3		24		dBm
噪声系数		1.8		dB
工作电流	65	89	115	mA

增益

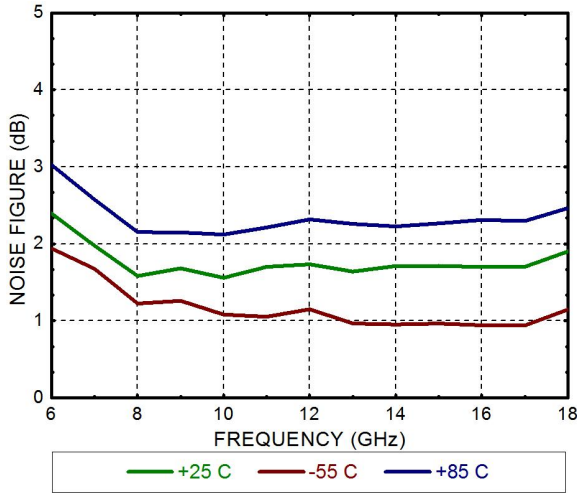


回波损耗

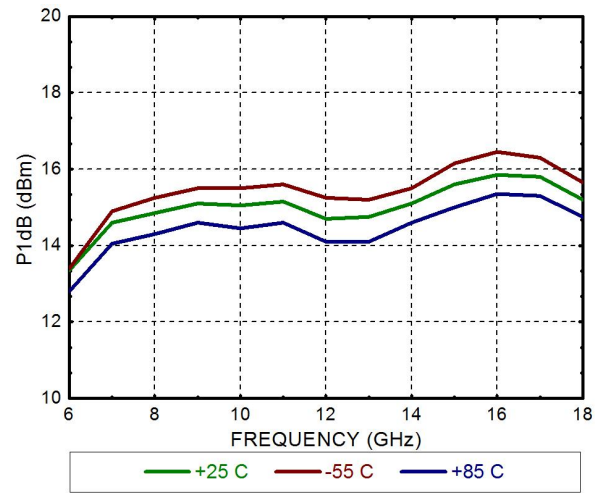




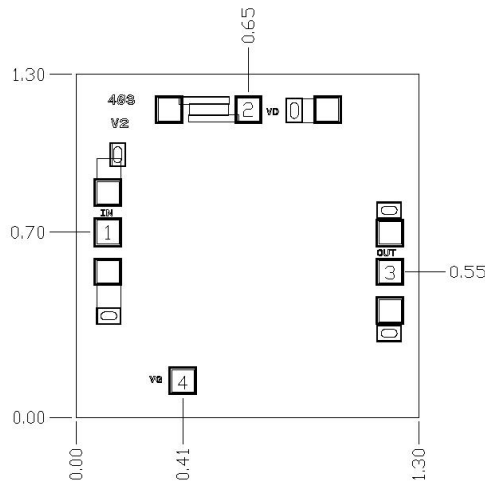
噪声系数



输出功率 $P_{1dB}$



物理参数

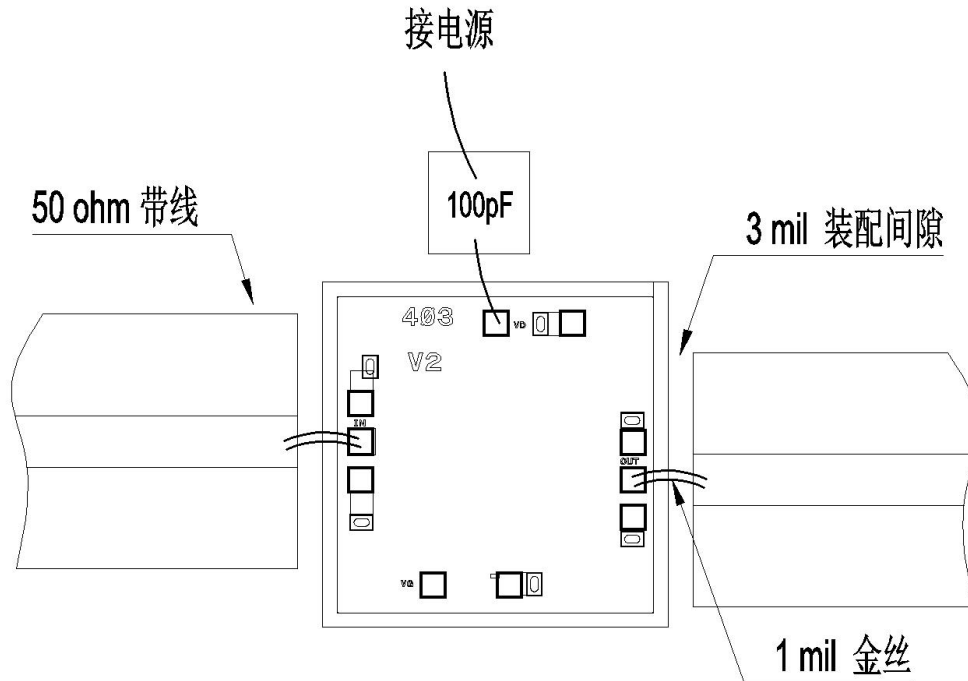


焊盘描述

焊盘序号	功能	描述
1	IN	该焊盘是 AC 耦合, 并匹配至 50 Ohm
2	VD	该焊盘提供放大器的电源电压, 需要外接 100pF 旁路电容
3	OUT	该焊盘是 AC 耦合, 并匹配至 50 Ohm
4	VG	该焊盘正常使用时悬空, 若需调整增益可接-0.3—0.3V 电源电压
芯片背面	GND	芯片背面必须连接至 RF/DC 地



## 装配图



### 注意事项

1. 芯片厚度为 100  $\mu\text{m}$
2. 典型键合焊盘尺寸为  $100 \times 100 \mu\text{m}^2$
3. 键合焊盘金属化: 金
4. 芯片背面镀金
5. 芯片背面接地
6. 未标注的键合焊盘不需要连接
7. 本产品采用空气桥工艺, 表面不带钝化层

### 极限参数

1. 电源电压: +5 V
2. 射频输入功率: +18 dBm
3. 储存温度:  $-65 \sim +150 \text{ }^\circ\text{C}$
4. 工作温度:  $-55 \sim +85 \text{ }^\circ\text{C}$